AG-403氰化镀银光亮剂

产品说明书

一、特　点

1、镀层银白不发黄、广泛应用于装饰性电镀和电子、电器电镀；

2、镀层光亮区宽，低电流密度区也能获得满意的光亮度，适用于滚镀和挂镀；

3、既适用于薄银电镀，也适用于厚银(50mm)电镀；

4、镀层导电性、可焊性和抗变色性能好、价格低于国外同类产品。

二、配方和工艺条件

名　称	工艺条件
银含量	20～40g/L
游离氰化钾(挂镀)	100～120g/L
(滚镀)	120～140g/L
碳酸钾	5～10g/L
AG-403光亮剂A	10～15mL/L
AG-403光亮剂B	15～20mL/L
电流密度(挂镀)	1～3A/dm2
(滚镀)	0.1～0.5A/dm2
温 度	20～40℃
SA：SK	2：1
阴极移动或周期换向	需要

三、镀液配制

1、AG-403A是初级光亮剂，能使镀层结晶细致，DK范围扩大。如DK范围变窄和光亮区缩小时，可补加2～3mL/L。消耗量约为50～100mL/KAH；

2、AG-403B是主光亮剂，能使镀层产生镜面光亮，量不足时光亮变差，过多则影响焊接性，平时可每次添加2～4mL/L。消耗量约为300～500mL/L。

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。

3、游离氰化钾稍高些有助于镀层光亮。

南京华仁新材料科技有限公司